

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

2023年7月25日投资者关系活动记录表

编号：2023-05

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位 名称及人员姓名	兴业证券：王楠 兴业证券：章林 泰康资产管理有限责任公司：雷鸣 大家资产管理有限责任公司：卢婷
时 间	2023年7月25日
地 点	北京市顺义区文良街15号院
上市公司 接待人员姓名	国联万众公司高级管理人员安国雨、侯丽敏，办公室人员李雪荣。
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、本次投资者关系活动的主要内容如下： 1、参观国联万众公司、重组募投项目进展情况； 2、投资者提问环节。 二、投资者提问环节 Q：请介绍一下国联万众公司基本情况？ A：国联万众主营业务为氮化镓通信基站射频芯片的设计、销售，碳化硅功率模块的设计、生产、销售，主要产品包括氮化镓通信基站射频芯片、碳化硅功率模块等。主要产品通过与下游客户接洽产品的技术指标需求经国联万众设计芯片，委托氮化镓通

信基站射频芯片业务资产及负债进行代生产加工,最终由国联万众对下游制造企业销售芯片、模块等产品实现收入。

Q: 公司在建项目(募投项目)进展如何?募投建设项目预计什么时候贡献收益?

A: 国联万众正在进行芯片制造及封装测试专业化生产线建设,目前已完成厂房建设、第一阶段的净化工程装修和主体设备安装、调试。国联万众在预测期即将形成氮化镓通信基站射频芯片及器件、碳化硅功率模块的相关研发、设计、制造、封装测试、销售等方面均能独立运行的完整产业链,以及经客户认证的销售渠道等众多核心环节资产及资源。

Q: 公司产品市场情况如何?

A: 国联万众的产品应用领域广泛,氮化镓通信基站射频芯片主要客户为安谱隆等射频器件厂商,应用于5G通信基站建设;碳化硅功率模块主要应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域,目前已与比亚迪、智旋等重要客户签订供货协议并供货。

Q: 请介绍下公司产品情况?

A: 国联万众主要产品为氮化镓射频芯片和碳化硅功率模块等。

1、氮化镓射频芯片: 国联万众目前具有氮化镓射频芯片的设计能力,但尚未建成专业化生产线,主要产品经国联万众设计后主要委托氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债代工生产,并由国联万众对外销售。

2、碳化硅功率模块: 国联万众现有的碳化硅功率模块包括650V、1,200V和1,700V等系列产品,主要应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域,未来拟攻关高压碳化硅功率模块领域,进一步对高压碳化硅功率芯片(自用)和模块相关的刻蚀技术、氧化工艺、减薄技术、封装技术等方面进行深入研发,抢占行业技术高地,在智能电网、动力机车、轨道交通等高压、超高压领域抢占市场份额,实现对IGBT功率模块的部分替代。

Q: 请问公司销售模式?

A: 国联万众主要采用直销的模式, 销售流程主要包括客户开发、客户资格审核、产品规格审核、订单确认、订单评审、签订合同、交付以及售后服务等环节。

国联万众外销采用 CIF 或 FOB 模式, 以报关作为收入确认依据; 内销以签收作为收入确认时点。

Q: 请问公司未来发展战略?

A: 国联万众主营业务为氮化镓通信基站射频芯片的设计、销售, 碳化硅功率模块的设计、生产、销售, 主要产品包括氮化镓通信基站射频芯片、碳化硅功率模块等。

国联万众正在进行芯片制造及封装测试专业化生产线建设, 目前已完成厂房建设、第一阶段的净化工程装修和主体设备安装、调试, 预期在第一阶段生产线建设完成后, 国联万众将具备氮化镓射频芯片和碳化硅功率模块的设计、制造和封装测试的整体能力。同时, 国联万众未来拟重点攻关碳化硅功率模块领域, 进一步对碳化硅功率芯片(自用)和模块相关的刻蚀技术、氧化工艺、减薄技术、封装技术等方面进行深入研究, 抢占行业技术高地, 在智能电网、动力机车、轨道交通等高压、超高压领域抢占市场份额, 实现对 IGBT 功率模块的部分替代。

Q: 请问公司以前年度业绩波动, 2023 年业绩是否增长, 是否具备可持续性?

A: 2020 年、2021 年和 2022 年, 国联万众的经营业绩有所波动, 2021 年国联万众亏损主要系当期国联万众营业收入规模相对较小; 同时建设的厂房屋于 2021 年转固, 导致 2021 年折旧增加 882.00 万元。

近年来从国家到地方也相继制定了一系列产业政策来推动 5G 通信和宽禁带半导体产业的发展, 报告期内, 国联万众的主要客户均未发生重大变化, 预计对后续持续盈利能力不会有重大不利影响。同时, 国联万众正在进行芯片制造及封装测试专业化生产

线建设，目前已完成厂房建设、第一阶段的净化工程装修和主体设备安装、调试，预期在第一阶段生产线建设完成后，国联万众将具备氮化镓射频芯片和碳化硅功率模块的设计、制造和封装测试的整体能力，未来将进一步增强持续盈利能力。

国联万众正在进行芯片制造及封装测试专业化生产线建设，未来将具备氮化镓射频芯片和碳化硅功率模块的设计、制造和封装测试的整体能力。同时，国联万众未来拟重点攻关碳化硅功率模块领域，并计划在智能电网、动力机车、轨道交通等高压、超高压领域抢占市场份额，实现对 IGBT 功率模块的部分替代。碳化硅功率半导体市场正在快速增长，据 YOLE 数据，2021 年全球碳化硅功率半导体市场规模约为 10.9 亿美元，而到 2027 年全球碳化硅功率半导体市场规模将快速增至 62.97 亿美元，年均复合增长率约为 34%。2022 年，国联万众扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润已实现盈利。

故国联万众未来盈利能力具备稳定性和可持续性，本次收购国联万众有利于提高上市公司资产质量。

Q：请问国联万众减少关联交易措施的可行性及进展？

A：国联万众正在进行芯片制造及封装测试专业化生产线建设，未来将减少对中国电科十三所芯片及偶发性关联方设备的采购

目前，国联万众正在进行芯片制造及封装测试专业化生产线建设，现已完成厂房建设、第一阶段的净化工程装修和主体设备安装、调试。该生产线建设完成后，国联万众将形成氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块的相关研发、设计、制造、封装测试等方面均能独立运行的完整产业链。该产线建成达产后，将逐步自行生产所需芯片原材料，减少对中国电科十三所芯片的采购。扣除该影响及偶发性关联方采购设备，2022 年度，关联采购金额减少 5,130.64 万元，占当期备考合并财务报表中营业成本的比例为 3.24%。

Q: 请问国联万众的核心竞争力如何?

A: 1、完整产业链服务优势

本次重组的国联万众、博威公司、芯片资产组共同组成了在建或达产的氮化镓通信基站射频芯片及器件、碳化硅功率模块的相关研发、设计、制造、封装测试、销售等方面均可独立运行的完整产业链, 可以为客户提供更成熟的芯片研发、设计、制造、封装测试等服务, 具备强大的服务能力和竞争优势。

2、产品和技术优势

本次重组公司及资产的产品氮化镓通信基站射频芯片及器件、碳化硅功率模块及其应用, 设计制造研发过程, 技术环节均处于领先水平, 且产品均为国内少有的国产化较高, 且性能受到客户认证的产品。

3、研发优势

本次重组公司及资产经过多年技术迭代, 核心领域具备相关自主知识产权, 均以自主研发为主, 建立起一套符合行业发展特征、满足业务需要的研发体系。重组公司及资产拥有优秀、稳定的技术团队, 研发实力雄厚, 技术水平和科技创新能力都处于国内同行的领先水平, 承担过多个国家级半导体领域的重大工程和重大科技专项任务, 荣获多项国家及省级科研奖项。

4、客户及认证优势

半导体领域客户对采购原材料的质量有着严苛的要求, 对供应商的选择较为慎重, 进入客户的合格供应商名单具有较高的壁垒, 通常需进行较长时间的验证过程, 包括, 长期的验证、实验、试生产等, 待通过内部认证后, 客户将产品送至下游最终客户处, 获得其客户认可后, 才会对供应商进行认证, 最终实现正式供货。

本次重组公司及资产将客户拓展和维护作为重点发展战略之一, 经多年发展, 已拥有丰富的境内外优质核心客户资源, 主要客户为国际国内通信行业龙头、新能源汽车行业龙头等。重组公司及资产与客户建立了长期稳定的合作关系, 拥有较高的客户

壁垒优势。

Q: 请说明上市公司对国联万众在业务、资产、财务、人员、资源等方面的整合计划。

A: 重组后, 国联万众、博威公司将成为上市公司的控股子公司, 氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债将由上市公司或其指定的主体接收。上市公司将按照上市公司治理的要求进行有效管理, 在上市公司整体经营目标和战略规划下, 在业务、资源、资产、财务、人员和机构等方面对标的资产进行整合管控, 促进业务有效融合, 优化资源配置, 提高经营效率和效益, 提升上市公司整体盈利能力, 维护上市公司和全体股东的利益。

(一) 业务、资源整合

上市公司将国联万众的业务、经营理念、市场开拓等方面的工作进一步纳入上市公司整体发展体系中。在保持国联万众的独立性、规范治理以及相关法律法规允许情况下, 国联万众业务将纳入上市公司的统一规划, 发挥与上市公司的协同效应:

1、在采购方面, 上市公司将建立统一的采购平台和体系, 保障原材料供应, 降低综合采购成本;

2、在生产方面, 上市公司将进一步协调整体生产计划, 优化生产流程, 提高生产效率;

3、在销售方面, 上市公司将整合销售体系, 共享客户资源, 加强市场开拓能力, 提高市场占有率;

4、在研发方面, 上市公司将整合研发体系, 共同开发新技术、新产品。

(二) 资产整合

资产整合方面, 上市公司将把重组公司及资产纳入到整个上市公司体系进行通盘考虑, 将保障上市公司与重组公司及资产的资产完整, 同时统筹协调资源, 在保持重组公司及资产的独立性、规范治理以及相关法律法规允许情况下, 合理安排上市公司与重组公司及资产之间的资源分配与共享, 优化资源配置。

	<p>(三) 财务整合</p> <p>上市公司和重组公司及资产将继续保持独立的财务制度体系、会计核算体系；充分发挥各自资本优势，降低资金成本；加强内部审计和内部控制。上市公司和重组公司及资产将根据中国证监会和深交所的监管规定，严格执行上市公司财务会计制度、内审制度、资金管理制度等相关要求。</p> <p>(四) 人员整合</p> <p>上市公司将保持重组公司及资产原有经营管理团队的相对独立和稳定，并在业务层面授予其较大程度的自主度和灵活性，以保证交易完成后主营业务的稳定可持续发展。同时，上市公司也将进一步完善市场化激励机制，激发员工积极性，引入外部优秀人才。</p> <p>(五) 机构整合</p> <p>重组公司及资产将继续保持现有的内部组织机构独立稳定，执行规范的内部控制制度，全面防范内部控制风险。上市公司也将进一步完善重组公司及资产治理结构、机构设置、内部控制制度和业务流程，加强规范化管理，使上市公司与重组公司及资产形成有机整体，提高整体决策水平和风险管控能力。</p> <p>以上内容未涉及内幕信息。</p>
附件清单（如有）	未提供书面材料。
日期	2023年7月25日